|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **氏名** | |  | | | | | | | | | |
| **専門分類（コンサルタントを行なう上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。）※複数回答可** | | | | | | | | | | | |
| **大分類** | 半導体パッケージ | | | | サブストレート | | | プリント配線板（リジット・フレキ） | | |  |
| 設計 | | 製造 | 実装 | | 品質管理 |  | |  |  | |
| 経営 | | 営業 | 調達 | | 工場設営 |  | |  |  | |
| **小分類** | 設計：部品データ設計（基板構造含む）、配線設計、CAM出力、シミュレーション　等  製造：資機材（材料、薬剤、装置）、TH加工（穴あけ、めっき）、表面処理（OSP、金めっき）、製造技術、生産技術　等  実装：電子部品、搭載・接合技術　等  品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、 品質管理手法、クレーム対策技術　等  半導体プロセス：前工程、後工程　等  経営：経営管理、生産管理、情報システム　等  営業：マーケティング、技術営業　等  調達：設備調達、材料・部品調達　等  工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計　等  その他（　　　　　　） | | | | | | | | | | |

**レジュメ１（経歴及び今後の活動内容）**

**専門分類**

**専門分類において経験した業務の詳しい内容**

**レジュメ1作成時の注意事項**

専門分類で選択された項目のうち、ご自身が得意とする分類から順に取り挙げ、専門分類において経験した業務の詳しい内容、役割、期間（年数）等をA4サイズ２枚以内でご記入下さい。

ご記入にあたっては、日本語（フォントサイズ‘10.5’）をご使用下さい。

レジュメ１の作成後につきましては、「JPCA認定コンサルタント検定ご案内」をご参照下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

**専門分類**

**専門分類において経験した業務の詳しい内容**

**レジュメ1作成時の注意事項**

これまでの経験を活かして、コンサルタントとして（または企業内において）今後、どのような活動を目指しているか、ご自身の貢献領域、具体的な貢献内容、提案したい事項等をA4サイズ１枚以内でご記入下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

**今後の活動内容について**